



## RE900

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para 14 SMD TSOP I y 7 diferentes SMD TSOP II chips
- Distancia entre las zonas terminales 0,40 mm (15.7 mil); 0,50 mm (19.7 mil); 0,65 mm (26.5 mil); 0,80 mm (30 mil); 1,27 mm (50 mil)
- Diámetro de agujeros 1,00 mm
- Puntos de ruptura controlada prerrayados para separar módulo individuales de la placa de circuito impreso
- Bajo demanda se ponen a disposición gratuitamente los datos Gerber para la fabricación de la impresión de pasta de soldar
- Tamaño 72,60 x 76,20 mm

Módulo-No.	Typ	Pitch	Pin	Tamaño (mm)
RE900-01	TSOP I	0,400 mm	28, 40, 48, 60	12,00 x 18,00
RE900-02	TSOP I	0,500 mm	28, 32, 40, 48	12,00 x 20,00
RE900-03	TSOP I	0,500 mm	20, 24	6,00 x 16,00
RE900-04	TSOP I	0,650 mm	16, 24, 28, 36	12,00 x 14,00
RE900-05	TSOP II	0,800 mm	40, 44	11,50 x 18,80
RE900-06	TSOP II	1,270 mm	20, 24, 26, 28, 32	11,50 x 21,30